

2017-2022年中国半导体市场分析预测及发展趋势 研究报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2017-2022年中国半导体市场分析预测及发展趋势研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/201706/528056.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

目前国内半导体产业已经形成了从设计、制造、封测到终端并辅以材料、设备等支撑环节的完整产业链，部分企业进入了国外一线厂商的供应链，并开始步入规模扩张阶段，我国半导体产业每年有着超过2300亿美元的进口产品国产替代空间，结合国家强有力的政策扶持，我国半导体行业将步入发展快车道。

2014年中国集成电路产业销售额为3015.4亿元，同比增长20.2%。其中，设计业增速最快，销售额为1047.4亿元，同比增长29.5%；制造业受到西安三星投产影响，2014年增长率达到了18.5%，销售额达712.1亿元；封装测试业销售额1255.9亿元，同比增长14.3%。但半导体材料销售额刚突破百亿元人民币，半导体设备销售额仅为40.53亿元，产值全球占比分别仅为3.6%和1.7%，难以满足产业发展需求。

我国半导体产业各环节产值全球占比

智研咨询发布的《2017-2022年中国半导体市场分析预测及发展趋势研究报告》共十章。首先介绍了半导体相关概念及发展环境，接着分析了中国半导体规模及消费需求，然后对中国半导体市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国半导体面临的机遇及发展前景。您若想对中国半导体有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一部分 基础篇 14

第一章 半导体产业概述 14

1.1 全球半导体产业概述 14

1.1.1 全球半导体产业发展历程 14

1.1.2 全球半导体产业景气循环 18

1.1.3 半导体产业在现代国民经济中的重要地位 23

1.1.4 半导体产业关联度分析 24

1.2 中国半导体产业概述 25

1.2.1 中国半导体产业发展历程 25

1.2.2 中国半导体产业市场概述 26

1.3 半导体产业链结构 28

1.4 半导体产品分类 28

1.5 半导体制造流程 28

1.6 半导体集成电路类别 30

第二章 全球及中国半导体市场分析 33

2.1 全球半导体市场分析 33

2.1.1 全球半导体市场分析 33

全球半导体贸易统计组织(WSTS)的统计数据显示,2015年全球半导体产品的市场销售额为3352亿美元,同比下降0.2%,下滑的主要原因是PC销售额下降与智能手机增速放缓。不过,随着去库存逐步完成,加上汽车电子、物联网等新兴市场带动,半导体行业已经由寒转暖,行业先导指标北美半导体BB值已经连续10个月达到1以上。根据WSTS发布的最新预测报告,2016年、2017年全球半导体市场将分别达到3362亿美元、3465亿美元的销售额,新兴行业需求稳定增长。

全球半导体营收及增速

到2020年,MCU全球出货量将达到267亿颗,销售额将达到209亿美元;据YoleDevelopment预计,全球MEMS市场规模将从2015年的119亿美元增长到2021年的近200亿美元,年复合增率在9%左右。

全球MCU市场规模预测

2.1.2 全球半导体应用领域分析 33

2.1.3 全球半导体资本支出分析 34

2.1.4 全球半导体产能分析 34

2.1.5 2016全球半导体主要厂商排名 35

2.1.6 2016全球主要半导体厂商投资分析 37

2.2 2014-2017中国半导体市场分析 39

第二部分 产业链篇 42

第三章 全球及中国IC设计市场分析 42

3.1 IC设计行业概述 42

3.1.1 IC设计行业特点 42

3.1.2 IC设计流程 44

3.1.3 IC设计方法演进路线 46

3.1.4 SOC主要特性及关键技术 47

3.1.5 IC设计业务模式 49

3.1.6 IC设计竞争力影响因素 49

3.2 全球及中国IC设计行业发展概述 50

3.2.1 全球IC设计行业发展概述 50

3.2.2 中国IC设计行业发展概述 53

- 3.3 中国IC设计业SWOT分析 53
 - 3.3.1 中国IC设计业优势（S） 53
 - 3.3.2 中国IC设计业劣势（W） 54
 - 3.3.3 中国IC设计业威胁（T） 55
 - 3.3.4 中国IC设计业机会（O） 56
- 3.4 中国IC设计行业分市场分析 56
 - 3.4.1 中国消费类IC设计市场分析 56
 - 3.4.2 中国通信IC设计市场分析 57
 - 3.4.3 中国工业控制类IC设计市场分析 58
- 3.5 中国IC设计厂商分析 61
 - 3.5.1 大唐微电子 61
 - 3.5.2 杭州士兰 62
 - 3.5.3 中星微 63
 - 3.5.4 珠海炬力 64
 - 3.5.5 中国华大 66
 - 3.5.6 南山之桥 66
 - 3.5.7 北京北大众志 67
 - 3.5.8 北大青鸟集成电路 70
 - 3.5.9 北京海尔集成电路 70
 - 3.5.10 北京华虹集成电路 71
 - 3.5.11 北京畅讯科技 72
 - 3.5.12 北京东世科技 73
 - 3.5.13 北京弗赛尔 73
 - 3.5.14 北京格林威尔 74
 - 3.5.15 北京宏思电子 76
 - 3.5.16 北京科泰康 77
 - 3.5.17 北京明宇科技 78
 - 3.5.18 北京思旺电子 80
 - 3.5.19 北京微辰 82
 - 3.5.20 北京协同伟业 82
 - 3.5.21 北京芯晟 83
 - 3.5.22 北京兆日科技 84
 - 3.5.23 北京正有 85
 - 3.5.24 北京智源利 87
 - 3.5.25 北京东科微电子 88

- 3.5.26 北京方舟 89
- 3.5.27 北京福星晓程 90
- 3.5.28 硅谷数模 91
- 3.5.29 北京火马 93
- 3.5.30 北京六合万通 93
- 3.5.31 北京中庆微 94
- 3.5.32 北京奇普嘉 95
- 3.5.33 北京神州龙芯 96
- 3.5.34 北京清华同方微电子 97
- 3.5.35 北京润光泰力 98
- 3.5.36 威盛电子 99
- 3.5.37 上海复旦微电子 99
- 3.5.38 上海富士通微电子 101
- 3.5.39 艾迪悌新涛 101
- 3.5.40 上海得理 102
- 3.5.41 上海鼎芯 103
- 3.5.42 上海凯明信息 104
- 3.5.43 上海富瀚 105
- 3.5.44 上海华邦 105
- 3.5.45 上海华龙 105
- 3.5.46 上海交大汉芯 107
- 3.5.47 上海明波 108
- 3.5.48 上海奈米闪芯 108
- 3.5.49 上海胜德 109
- 3.5.50 上海微科 109
- 3.5.51 上海矽创 110
- 3.5.52 上海芯成 110
- 3.5.53 上海芯华 111
- 3.5.54 上海芯原 112
- 3.5.55 上海新茂 112
- 3.5.56 上海智芯科 113
- 3.5.57 上海智原科技 113
- 3.5.58 上海展讯 114
- 3.5.59 上海德律风根 115
- 3.5.60 上海华亚微电子 116

- 3.5.61 上海京西电子 116
- 3.5.62 上海力通微 116
- 3.5.63 上海扬智 117
- 3.5.64 晶门科技 119
- 3.5.65 埃派克森 120
- 3.5.66 深圳剑拓科技 121
- 3.5.67 深圳艾科创新 122
- 3.5.68 深圳爱思科 122
- 3.5.69 深圳爱芯 123
- 3.5.70 深圳国微 123
- 3.5.71 深圳海思 124
- 3.5.72 深圳美芯 126
- 3.5.73 深圳芯邦微电子 127
- 3.5.74 深圳中颖 127
- 3.5.75 希格玛晶华 128
- 3.5.76 安凯开曼 129
- 3.5.77 厦门联创 129
- 3.5.78 广州精芯 130
- 3.5.79 成都国腾 131
- 3.5.80 成都华微 132
- 3.5.81 成都威斯达 133
- 3.5.82 四川虹微 134
- 3.5.83 艾博科技 134
- 3.5.84 苏州国芯 136
- 3.5.85 苏州华芯 136
- 3.5.86 苏州世宏 137
- 3.5.87 江苏意源 138
- 3.5.88 杭州国芯 139
- 3.5.89 绍兴芯谷 140
- 3.5.90 无锡爱芯科 141
- 3.5.91 无锡亿晶 141
- 3.5.92 无锡盈泰 142
- 3.5.93 中电55所 142
- 3.5.94 西安联圣 143
- 3.5.95 西安深亚 145

- 3.5.96 飞思卡尔 146
- 3.5.97 重庆西南集成 148
- 3.6 中国IC设计投资分析 149
- 第四章 全球及中国IC制造市场概述 153
 - 4.1 2008-2012全球IC制造市场概述 153
 - 4.2 2008-2012中国IC制造市场概述 154
 - 4.3 全球及中国主要IC制造厂商分析 154
 - 4.3.1 全球主要IC制造厂商 154
 - 4.3.1.1 台积电 154
 - 4.3.1.2 台联电 159
 - 4.3.1.3 新加坡特许半导体 159
 - 4.3.2 中国主要IC制造厂商 160
 - 4.3.2.1 中芯国际 160
 - 4.3.2.2 华虹 161
 - 4.3.2.3 上海宏力 166
 - 4.3.2.4 上海新进 167
 - 4.3.2.5 江苏和舰 168
 - 4.3.2.6 上海先进 169
 - 4.3.2.7 珠海南科 169
 - 4.3.2.8 中纬积体 171
 - 4.3.2.9 首钢日电 171
 - 4.3.2.10 华越微电子 172
 - 4.3.2.11 华润微电子 172
 - 4.3.2.12 无锡友达 173
 - 4.3.2.13 安博电子 174
 - 4.3.2.14 西岳电子 175
 - 4.3.2.15 柏玛微电子 175
 - 4.3.2.16 其它晶圆厂 176
 - 4.4 全球四大晶圆厂对比分析 177
 - 4.4.1 全球四大晶圆代工厂经营状况比较 177
 - 4.4.2 全球四大代工厂商代工厂比较 178
 - 4.5 小结 180
- 第五章 2015-2017全球及中国IC封测市场分析 181
 - 5.1 IC封测概述 181
 - 5.1.1 IC封测概述 181

- 5.1.2 主要IC封装技术比较 181
- 5.1.3 IC封装发展趋势 184
- 5.2 全球IC封测概述 186
- 5.3 中国IC封测概述 187
- 5.4 中国主要IC封测厂商 190
 - 5.4.1 江苏长电 190
 - 5.4.2 北京自动测试技术研究所 191
 - 5.4.3 南通富士通微 193
 - 5.4.4 华越芯装 193
 - 5.4.5 乐山菲尼克斯 194
 - 5.4.6 宁波明昕 195
 - 5.4.7 天水华天 196
 - 5.4.8 北京微电子技术研究所 197
- 第六章 全球及中国半导体设备市场分析 198
 - 6.1 半导体设备行业概述 198
 - 6.2 世界半导体设备市场分析 199
 - 6.3 中国半导体设备市场分析与预测 199
 - 6.4 中国半导体二手设备市场分析 199
 - 6.5 中国半导体设备主要厂商分析 204
 - 6.5.1 七星华创 204
 - 6.5.2 铜陵三佳电子 205
 - 6.5.3 中电45所 206
 - 6.5.4 中电48所 207
 - 6.5.5 西北机器厂 210
 - 6.5.6 兰州兰新 211
 - 6.5.7 北京中科信 212
 - 6.5.8 沈阳芯源 213
 - 6.5.9 青岛旭升 214
 - 6.5.10 商巨科技 214
 - 6.5.11 上海微高 215
 - 6.5.12 上海依然 215
 - 6.5.13 成都南光 216
 - 6.5.14 汉唐科技 217
 - 6.5.15 江苏苏净 217
 - 6.5.16 爱德万 218

6.5.17 泰瑞达	218
6.5.18 AEHR老化系统公司	219
6.5.19 科利登	220
6.5.20 东京精密	221
第七章 全球半导体原材料市场分析	223
7.1 半导体原材料行业概述	223
7.2 全球半导体原材料市场分析	224
7.3 中国半导体原材料市场分析	225
7.4 中国半导体原材料主要厂商分析	231
7.4.1 有研硅股	231
7.4.2 上海合晶	231
7.4.3 万向硅峰	232
7.4.4 宁波立立	233
7.4.5 洛阳单晶硅	234
7.4.6 峨嵋半导体	235
7.4.7 浙大海纳	237
7.4.8 国瑞电子材料有限公司	238
7.4.9 北京化学试剂研究所	239
7.4.10 中电华威	241
7.4.11 有研亿金	242
7.4.12 河北普兴电子材料有限公司	243
7.4.13 贺利氏招远贵金属材料	243
7.4.14 上海申和热磁	244
7.4.15 乐山新光	245
7.4.16 上品综合	245
7.4.17 宁波东盛集成电路元件厂	246
7.4.18 河北晶龙	246
7.4.19 广州半导体材料研究所	248
7.4.20 广州爱斯佩克	249
7.4.21 上海光刻电子	249
7.4.22 苏州瑞红	249
7.4.23 长沙韶光	252
7.4.24 厦门永红电子有限公司	253
7.4.25 宁波康强	253
第三部分 发展篇	256

第八章 中国半导体产业区域分析 256

8.1 长江三角洲 256

8.1.1 上海 256

8.1.2 江苏 257

8.1.3 浙江 266

8.2 京津环渤海湾 268

8.2.1 北京 268

8.2.2 河北 269

8.2.3 山东 273

8.2.4 辽宁 274

8.2.5 天津 277

8.3 珠江三角洲 279

8.3.1 深圳 279

8.4 西部地区 280

8.4.1 西安 280

8.4.2 四川 281

8.4.3 重庆 282

第九章 中国半导体产业环境分析 283

9.1 中国半导体产业投融资环境分析 283

9.2 中国半导体产业政府政策分析 283

9.2.1 全球主要国家半导体产业政策分析 283

9.2.2 中国半导体产业政策分析 287

9.3 中国硅知识产权 (IP) 产业分析 287

9.3.1 IP产业概述 287

9.3.2 IP基本概念与相关流程 288

9.3.3 IP市场前景分析 288

9.3.4 中国IP行业存在的主要问题 289

9.3.5 中国IP行业新进展 294

9.3.6 中国IP产业调查 299

9.3.7 小结 302

第十章 执行总结 304 (ZY LT)

图表目录：

图表 1 2014-2016年我国单晶硅材料供应分析 34

图表 2 2014-2016年我国氮化镓材料供应分析 41

图表 3 2013-2016年全球半导体行业总体规模 57

- 图表 4 2013-2016年全球集成电路行业总体规模 57
 - 图表 5 2013-2016年全球半导体分立器件行业总体规模 57
 - 图表 6 2013-2016年全球光电子器件行业总体规模 58
 - 图表 7 英特尔经营情况分析 66
 - 图表 8 德州仪器经营情况分析 71
 - 图表 9 高通经营情况分析 77
 - 图表 10 飞思卡尔经营情况分析 85
 - 图表 11 AMD经营情况分析 90
 - 图表 12 亚德诺半导体技术公司经营情况分析 95
 - 图表 13 2016年日本电气股份有限公司经营情况分析 99
 - 图表 14 2016年东芝经营情况分析 101
 - 图表 15 意法半导体经营情况分析 104
 - 图表 16 2016年三星电子经营情况分析 109
 - 图表 17 2013-2016年我国半导体产业市场总规模分析 123
 - 图表 18 2013-2016年我国集成电路产业市场总规模分析 123
 - 图表 19 2013-2016年我国分立器件产业市场总规模分析 124
 - 图表 20 idm商业模式 125
 - 图表 21 垂直分工商业模式 127
 - 图表 22 IP市场的收费模式 128
 - 图表 23 IP核的硅验证及SOC验证 128
 - 图表 24 2013-2016年我国集成电路设计行业发展规模分析 146
 - 图表 25 2013-2016年我国集成电路制造行业发展规模分析 147
 - 图表 26 2013-2016年我国集成电路封测行业发展规模分析 152
 - 图表 27 2013-2016年我国集成电路行业企业数量分析 157
 - 图表 28 2013-2016年我国集成电路行业资产规模分析 157
 - 图表 29 2013-2016年我国集成电路行业销售收入分析 158
 - 图表 30 2013-2016年我国集成电路行业利润总额分析 158
- 更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201706/528056.html>